

中信建投证券股份有限公司
关于联芸科技（杭州）股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：联芸科技（杭州）股份有限公司
保荐代表人姓名：包红星	联系方式：010-56052591 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
保荐代表人姓名：郭泽原	联系方式：010-56052363 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2024〕906 号文”批准，联芸科技（杭州）股份有限公司（简称“公司”或“联芸科技”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元。本次公司发行新股的发行价为 11.25 元/股，募集资金总额为 1,125,000,000.00 元，扣除发行费用 91,634,240.24 元后，实际募集资金净额为 1,033,365,759.76 元。本次公开发行股票于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	保荐人、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。	保荐人、保荐代表人已协助和督促联芸科技建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，符合法律法规和本规则的要求。联芸科技及其实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员已知晓其在本规则下的各项义务。
2	保荐人、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公	保荐人、保荐代表人已持续督促联芸科技充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，联芸科技信息披露真实、准确、完整、

	工作内容	持续督导情况
	平。 保荐人、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。 保荐人、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	及时、公平。 保荐人、保荐代表人已对联芸科技制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。 保荐人、保荐代表人已督促联芸科技实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助联芸科技隐瞒重要信息。 2026 年半年度，联芸科技信息披露情况真实、准确、完整、及时、公平。
3	上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐人、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐人、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的，保荐人和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	保荐人、保荐代表人已督促联芸科技实际控制人对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐人、保荐代表人已针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，并督促相关主体及时、充分履行承诺。 2026 年半年度，联芸科技或其实际控制人承诺履行情况良好，符合法律法规、本规则以及交易所其他规定。
4	保荐人、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐人、保荐代表人已督促联芸科技积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
5	保荐人、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。 保荐人、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性	2026 年半年度，保荐人、保荐代表人持续关注联芸科技运作，对联芸科技及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料等方式，关注联芸科技日常经营和股票交易情况。 在本持续督导期间，联芸科技不存在重大风险或重大负面事项。

	工作内容	持续督导情况
	陈述或者重大遗漏的，保荐人、保荐代表人应当发表意见予以说明。	
6	上市公司股票交易出现严重异常波动的，保荐人、保荐代表人应当督促上市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。	2026 年半年度，联芸科技股票交易未出现严重异常波动。
7	保荐人、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐人、保荐代表人已督促实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺。2026 年半年度，前述主体未减持公司股份。
8	保荐人、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。	保荐人、保荐代表人已关注联芸科技使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现联芸科技存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

集成电路设计行业具有竞争激烈、研发投入大、不确定性较高、产品更新换代较快的特点。2026 年上半年，公司研发费用占营业收入的比例超过 35%。数据存储主控芯片涉及领域较多，且每款接口的升级迭代速度较快。同时，AI 时代的到来，正在彻底重构全球存储产业的格局。过去，存储只是算力系统的配套配件；而现在，存储已经成为决定算力上限的核心战略资源和制约产业扩张的核心瓶颈，数据存储主控芯片作为数据交互的核心枢纽，正处于战略机遇窗口期。公司数据存储主控芯片业务如未来未能及时推出适配新技术、新标准的芯片产品，随着行业终端产品全面升级至新标准，公司现有产品虽仍具备一定市场需求，但随着下游应用逐步向新技术、新标准迁移，其销售收入增长空间或将受到制约，市场竞争力亦可能逐步弱化，进而对公司经营业绩的增长性产生不利影响。

AIoT 信号处理及传输业务尚处于起步阶段，且研发投入较大。若公司产品研发失败，存在前期投入资金无法收回的风险。同时，AIoT 领域技术迭代迅速，新的信号处理算法、传输协议不断涌现。公司若不能及时跟上技术更新步伐，研发出适配新技术标准的芯片产品，其现有的产品可能因技术落后而失去竞争力。

（二）经营风险

1、客户集中度较高风险

公司的芯片产品主要采用直销模式向模组厂商或终端设备厂商销售产品，受已开发完成的客户持续放量、新客户尚处于开拓周期、产品下游应用领域等因素影响，公司存在客户集中度较高的情况。公司的经营业绩与下游模组厂商、终端设备厂商的经营情况相关性较高，如未来该等厂商的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公司与该等厂商的合作关系发生变化，公司将面临订单减少或流失等风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

2、供应商集中风险

公司为典型的采用 Fabless 经营模式的集成电路设计企业，专注于芯片设计，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等生产环节采用委托第三方企业代工的方式完成。由于集成电路行业的特殊性，晶圆生产制造环节对技术及资金规模要求较高且市场集中度很高，能够满足公司业务需求的具备先进工艺的厂商数量更少。行业内，众多集成电路设计企业出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别晶圆厂和封测厂进行合作。

由于主要供应商集中，如果供应商发展经营不善或与公司合作受限，公司需要短期内找到合适的替代供应商，否则将影响产品的稳定生产。同时，如果未来国际出口管制和贸易摩擦加剧，使得公司相关原材料进口受到限制，影响订单正常履行，也将会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

（三）财务风险

1、存货跌价风险

2026 年上半年，公司战略备货增加，期末存货账面价值 63,856.10 万元，占期末资产总额的比例 21.27%。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新

导致存货积压，则公司存货可能面临跌价风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、应收账款回收风险

2026 年上半年末，公司应收账款账面价值为 34,548.38 万元，占期末资产总额的比例为 11.51%，应收账款账面余额占当期营业收入的比例为 40.86%。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能继续增加，如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化或个别客户经营状况发生困难，公司存在因应收账款难以收回而发生坏账的风险，进而对公司未来业绩、现金流量造成不利影响。

（四）行业风险

数据存储主控芯片行业集中度相对较高，主要市场包括三星、西部数据、慧荣科技、联芸科技等头部企业占据，但也不缺新兴进入者的搅局。公司虽然在 SSD 主控芯片领域占有全球重要一席，市场份额逐年提升，但依然要面对技术的迭代创新速度、后进入者的杀价及阶段性支持资源不足丢失市场的风险。另外，嵌入式存储主控芯片是公司最新进入的业务领域，该领域主要被海外厂商垄断，市场拓展遇到的挑战更大。

AIoT 信号处理及传输芯片具有较高的技术、应用和资金壁垒，全球拥有突出研发实力和规模化运营能力的芯片厂商主要集中在境外，美满电子和瑞昱等国际巨头呈现高度集中的市场竞争格局。与上述行业龙头相比，公司在市场份额、产品布局、经营规模、盈利能力等方面均存在明显差距。公司目前在 AIoT 信号处理及传输芯片领域内属于起步阶段，如果未来市场推广不如预期，可能存在无法实现进一步大规模销售的情况。

（五）宏观环境风险

近年来，国际贸易中部分国家针对半导体设备领域颁布了一系列对中国的出口管制政策，同时，陆续将多家中国半导体企业纳入“实体清单”（Entity List）和“未经核实清单”（Unverified List），限制其采购受《出口管制条例》管辖的物品。

随着全球主要经济体经济增速持续放缓，贸易保护主义及国际经贸摩擦的风

险仍将存在，不能排除国际贸易政策未来变化会对国内芯片设计企业带来一定的限制和不利影响，从而影响本土半导体产业链完整、持续、稳定的发展。随着相关事态的发展，贸易政策发生不利变化，公司可能面临相关订单减少的局面，进而对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，联芸科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年 1-6 月，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	854,109,397.31	609,721,474.32	40.08
利润总额	519,551,700.50	56,134,963.73	825.54
归属于上市公司股东的净利润	519,551,700.50	56,134,963.73	825.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,525,153.84	35,093,418.32	61.07
经营活动产生的现金流量净额	134,692,774.19	-17,969,442.78	不适用
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年 12 月末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,431,956,449.37	1,905,695,064.41	27.62
总资产	3,002,773,402.71	2,354,970,788.46	27.51

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.13	0.12	841.67
稀释每股收益 (元/股)	1.13	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.08	50.00
加权平均净资产收	23.84	3.21	增加 20.63 个百分点

主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.59	2.00	增加 0.59 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	35.58	40.89	减少 5.31 个百分点

2026 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、2026 年上半年公司营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系：

(1) 2026 年上半年，公司聚焦存储主控主业，把握行业景气机遇，PCIe3.0、PCIe4.0、PCIe5.0 及企业级 SATA 主控芯片等产品持续受益市场扩容，出货量继续保持稳步增长；

(2) 公司在新产品开发及量产方面取得阶段性进展，新产品出货稳步推进放量。

2、2026 年上半年利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加，主要系：

(1) 主营业务收入稳步增长，带动扣非净利润同比增长 61.07%；

(2) 公司通过战略配售持有的股份本期确认的公允价值变动收益大幅增加。

3、2026 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所改善，主要系销售回款较去年同期大幅增加。

4、2026 年上半年公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均同比增加，主要系净利润和扣除非经常性损益后净利润均同比增加。

5、研发投入占营业收入的比例同比下降，主要系 2026 年上半年营业收入同比增幅大于研发费用同比增幅。

六、核心竞争力的变化情况

2026 年上半年，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）自主创新的研发平台体系

公司建立了以研发平台为核心的多部门协调参与的研发体系，构建起围绕 SoC 芯片设计平台的技术研发、中后端设计服务、芯片验证等多环节研发体系。公司基于多年对电路设计、工艺制造、封装测试等环节从业经历与经验，针对不同产品线技术及市场发展特点，构建可共享、可复用的 IP 及 SoC 架构设计技术，最大限度地降低研发成本，实现了研发资源的高效共享，缩短产品从设计到量产的研发周期。公司根据不同产品线技术特点，通过大量数据分析及模拟验证，总结出不同产品线产品设计的技术要点，建立针对不同产品线可共享复用的设计 IP 模块，为后续跨产品线芯片产品快速量产和演进打下坚实基础。

（二）已进入行业主要客户的供应链体系

公司经过多年的积累和发展，在业内获得了广泛认可，成为具有一定影响的数据存储主控芯片和 AIoT 感知信号处理与传输芯片提供商。在消费级零售 SSD 应用领域：除部分 NAND 原厂品牌 SSD 尚未使用外，全球大部分 SSD 品牌均有采用公司 SSD 主控芯片及解决方案；在消费级 PC-OEM 前装 SSD 应用领域：公司消费级 SSD 主控芯片已广泛应用于众多品牌 PC 电脑中；在企业级 SSD 应用领域：公司 SATA 主控芯片已在众多服务器厂商中获得规模商用。公司嵌入式存储主控芯片下游客户和终端用户高度一致，现有 SSD 合作伙伴将是嵌入式存储主控芯片的重要资源。在 AIoT 感知信号处理与传输芯片领域，相关产品也获得 AIoT 头部企业规模商用，与头部客户建立起深度且长期的合作关系。

（三）经验丰富的人才团队

公司拥有一支高素质的设计研发人才队伍，截至 2026 年 6 月 30 日，联芸科技研发团队规模超过 800 人，公司研发人员占总员工比例达到 84.40%。公司研发人员理论基础扎实、实践经验丰富、知识结构合理，具备并行开发多款数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片能力，在公司各个关键岗位上发挥重要作用，能够有力支撑公司的技术创新和产品迭代，保证研发任务的顺利完成。

（四）相辅相成的业务布局

公司产品线从最初的数据存储主控芯片到 2017 年布局 AIoT 感知信号处理芯片，并在 2019 年开始布局有线通信芯片业务。经过十年多的发展，初步构建起从感知信号处理、数据有线传输到数据存储所需的核心芯片，形成多样化产品布局 and 多元化业务矩阵，抗风险能力持续增强。集成电路芯片的研发具有出错成本高、资金投入大、开发周期长等特点，同时 AIoT 市场仍处于快速发展周期，新技术、新产品层出不穷，带来了芯片产品能够快速实现技术更新迭代的要求，比如智能家居、汽车电子等行业。而公司数据存储主控芯片和 AIoT 感知信号处理及传输芯片同属于系统级大规模集成电路芯片，在技术上可以充分实现通用 IP 技术共享、SoC 芯片设计平台技术共享，不仅有效节省了芯片研发成本，缩短了芯片研发周期，而且降低了芯片出错概率。另外，公司数据存储主控芯片和 AIoT 感知信号处理及传输芯片全面应用于数据的处理、传输、存储，相辅相成，终端客户群也高度一致，能够最大发挥多样化产品矩阵优势。

七、研发支出变化及研发进展

2026 年上半年，公司研发费用为 3.04 亿元，占营业收入的比例为 35.58%，研发投入强度保持较高水平。公司持续扩大研发人员队伍，依托股权激励工具吸引、留住核心技术人才，搭建梯队合理、创新实力突出的研发团队，提升研发成果转化效率。截至 2026 年 6 月末，公司研发人员规模超 800 人，研发人员占员工总人数比重达 84.40%。

同时，公司持续完善 SoC 芯片设计全流程自主研发平台，不断强化芯片设计、验证能力，缩短产品从设计到量产的研发周期，保持技术领先性。截至 2026 年上半年，公司在数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片领域已积累丰富的知识产权体系，累计拥有有效授权发明专利 115 件、软件著作权 69 件、集成电路布图设计 29 件。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

发行名称	2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024 年 11 月 22 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
募集资金总额	1,125,000,000.00
减：	
已支付的发行费用	91,633,240.23
以前年度已使用金额(包括实际已置换先期投入金额)	340,095,975.89
本年度使用金额	456,032,542.72
暂时补流金额	
现金管理金额	82,000,000.00
银行手续费支出	241.23
加：	
募集资金现金管理收益	6,092,000.47
募集资金利息收入	5,402,583.37
报告期期末募集资金余额	166,732,583.77

公司 2026 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2026 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目拟变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构的议案》，同意将“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”的实施方式由“建设总部基地大楼”变更为“购置总部基地大楼”，实施地点仍为杭州市滨江区物联网小镇园区，实施主体仍为公司，且公司将对该募投项目的投资金额及内部投资结构进行调整，即在募集资金承诺投资总额不变的前提下，对项目投资金额及内部的场地建设及装修费用、研发费用等投入金额进行调整。调整前，“联芸科技数据管理芯片产

业化基地项目”投资金额为 78,625.28 万元,拟使用募集资金金额 41,452.14 万元;调整后,该募投项目投资金额为 54,169.94 万元,拟使用募集资金金额不变。2026 年 3 月 25 日,该议案经 2026 年第一次临时股东会审议通过。上述事项公司已经进行了公告。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司实际控制人、董事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于联芸科技（杭州）股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 包红星 郭泽原
包红星 郭泽原

